

【1000 ~ 1400万円】バイリンガル組込みソフトウェアエンジニア【日系医療機器メーカー】

> 外資系エンジニアリングメーカーでの募集です。 弱電回路設計のご経験のある方は歓...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
外資系エンジニアリングメーカー

Job ID
1619726

Industry
Electronics, Semiconductor

Company Type
International Company

Job Type
Permanent Full-time

Location
Tokyo - Other Areas

Salary
10 million yen ~ 14 million yen

Work Hours
09:00 ~ 18:00

Holidays
詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

Refreshed
October 29th, 2026 18:18

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2354556】
医療機器向けバイリンガルハードウェアアーキテクトとして、シニアテクニカルリーダーの役割を担い、技術規格や各種規制を遵守しながら、診断・モニタリング用医療機器の設計・開発およびライフサイクル管理をリードします。システムエンジニアリングの高い専門性を活かし、顧客のニーズや課題を正確に把握し対話しながら、要件定義から製品化までのエンジニアリングソリューションを提供。ハードウェア・ソフトウェアの両面を統合的に管理し、オフショアの各チームと協働して顧客満足度の高い成果を目指します。提案活動にも積極的に関わり、腎臓デバイス（透析）の経験があれば活かせます。

【魅力】
長期的かつスケーラブルな新規事業にコアメンバーとして携わり、企業の成長に貢献できる機会があります。
【成長機会】
経験を積むことでシニアアーキテクトやプリンシパルアーキテクトへの昇進が可能。営業やデリバリー、事業投資に関わるリーダーシップポジションなど多様なキャリアパスもあります。

Required Skills

■必須要件■ Must Have
・製品開発ワークフロー、特にハードウェア設計・開発に関する知識
・回路図入力ツール（Cadence Allegro/Mentor Graphics/Zuken/Altium）の使用経験、部品選定、DC DCコンバータなどの電源部品、低電圧信号処理回路設計、トランスデューサインターフェース設計、部品公差解析の経験
・8/16/32ビットプロセッサベースの設計やメモリインターフェース（SDRAM、Flash）などのアーキテクチャに関する実務経験
・技術文書作成スキル：ハードウェア製品の仕様書とテスト手順書の作成経験
・ボードの立ち上げ、製品テスト手順、EMI/EMC適合性試験を含むテスト経験、オシロスコープ、マルチメータ、プログラマブルテスト負荷などの試験機器に関する知識

■尚可要件■ Good to Have
・医療機器製品規格（IEC60601 1）、医療機器製品開発ライフサイクルプロセスおよび関連文書・製品情報管理（PIM）および製品ライフサイクル管理（PLM）ツールの知識

■語学力■ Language Skill
英語力 - 日常会話レベル（会話、読解、文書作成など）
日本語力 ネイティブレベル / JLPT N2レベル以上（良好なコミュニケーション能力、読解力、文章力、プレゼンテーション能力必須）

Company Description

ご紹介時にご案内いたします